19a-P2-1 AllnAs 酸化電流狭窄型 GalnAsP/SOI ハイブリッドレーザ構造の

# 高温プロセスによる影響

Influence of High Temperature Process to GaInAsP/SOI Hybrid Laser Structure with AlInAs Oxidation Current Confinement Layer 鈴木純一1 林侑介1 渥美裕樹1 姜晙炫1 西山伸彦1 荒井滋久1.2 Junichi Suzuki1 Yusuke Hayashi1 Yuki Atsumi1 JoonHyun Kang1 Nobuhiko Nishiyama1 Shigehisa Arai1.2 1東京工業大学 電気電子工学専攻、2量子ナノエレクトロニクス研究センター 1Dept. of Electrical and Electronic Engineering, 2Quantum Nanoelectronics Research Center Tokyo Institute of Technology, E-mail: suzuki.j.af@m.titech.ac.jp

## <u>1. はじめに</u>

Si プラットフォーム上への III-V 族半導体光デバ イス集積は光ルータや WDM 送受信機などの大規 模光集積回路実現に有効なアプローチである[1]。 この III-V/Si ハイブリッド集積を利用したレーザ、 半導体光増幅器に適した電流狭窄構造として、本 研究グループではストライプ幅制御性、屈折率制 御性で優れた特性が期待される AllnAs 酸化狭窄構 造を提案している[2][3]。今回、高温加熱酸化プロ セスに起因する活性層へのダメージを低減する方 法を検討したのでご報告する。

#### <u>2. 結果</u>

実験に使用したウェーハ構造を Fig. 1 に示す。 220 nm 厚の Si 層を有する SOI 基板上に GaInAsP 5 層量子井戸を含む層をプラズマ活性化接合 (150℃)で貼り付けた構造となっている。III-V/Si 間で発生する熱応力が活性層に与えるダメー ジを緩和するため、GalnAsP/InP 超格子層 (GalnAsP/InP = 7 nm/6 nm×14 層)を接合界面 に導入した。酸化プロセスでは、200℃ に予備加 熱したチャンバーに試料を入れ、AllnAs 層の酸化 温度(530°C)まで昇温し、所望の時間経過後、 再度 200℃ まで降温して試料を取り出した。超格 子を導入していないウェーハの従来の酸化実験に おいては、昇温時間10分、降温時間を自然冷却 で 1 時間とした際に、酸化後のフォトルミネッセ ンス(PL) 強度は 20%程度にまで低減していた。 これを改善するため、今回、超格子層の導入およ び昇温・降温時間の延長を試行した。

Fig. 2(a)に昇温時間を 10 分と固定し降温時間 をパラメータとしたとき、Fig.2(b)に降温時間を 4 時間と固定し昇温時間をパラメータとしたときの PL ピーク強度依存性を示す。超格子構造を導入し た結果、酸化前の PL 強度が 2 倍に増大した。昇 温時間、降温時間を延長することにより PL ピー ク強度は増加したが、降温時間 4 時間以上の場合 には変化は見られなかった。最終的に昇温時間お よび降温時間を 4 時間と長くした結果、酸化前に 比べて 60% (Fig.3)の PL 強度が得られた。また、 昇温時間および降温時間を 4 時間とした酸化前後 の PL スペクトルの半値全幅は、それぞれ 39 meV, 32 meV であった。今後は昇温時間の延長および 酸化温度の低減化による PL 強度の改善可能性を 探る。

#### <u>3. 謝辞</u>

本研究は文部科学省科学研究費補助金(#24246061,



Fig. 1 Schematic structure of the wafer for oxidation process.







Fig. 3 PL spectrum before and after oxidation.

#25709026, #13J08096, #11J08863)、総合科学学 術会議により制度設計された JSPS-FIRST プログ ラムおよび経済産業省未来開拓研究プロジェクト の援助により行われた。

### <u>4. 参考文献</u>

- [1] B. B. E. Little, *et al.*, *Opt. Photon. News*, pp. 24-29 (2000).
- [2]長部亮, 他, 応用物理学会'11 秋, vol.21, no.5, pp.9210 (2011).
- [3] Y. Hayashi, *et al.*, LTB3D 2012, pp. 93-94. (2012).